

Karta techniczna

Opis produktu:

Profesjonalny klej w pianie do mocowania płyt izolacyjnych na fasadach, fundamentach i dachach. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do materiałów budowlanych, takich jak styropian EPS, XPS, płyty poliuretanowe (PIR i PUR), beton, metal, płyty kartonowo-gipsowe, drewno, ceramika, a także dachów płaskich pokrytych papą lub blachą stalową ocynkowaną. Zastosowana nowoczesna formuła gwarantuje znakomite właściwości izolacyjne (λ 0,034W/m²K) oraz wysoką siłę mocowania wstępnego w szerokim zakresie temperatur (od -5°C do +30°C). Produkt sprawdzony przez profesjonalistów na różnych podłożach mineralnych. Klejenie bez pyłu, bez konieczności dostępu wody i prądu, bez dźwigania. Wysokowydajny - jedno opakowanie zapewnia mocowanie do 12m².

Zgodnie z KOT do mocowania białych i grafitowych płyt styropianowych oraz płyt XPS, płyt PIR do podłoża mineralnych (na przykład betonowych, ceramicznych), czy ociepleniu ścian budynków metodą bezspoinową (ETICS) i ocieplaniu dachów.

Ponadto można stosować do klejenia parapetów zewnętrznych i wewnętrznych z kamienia, konglomeratu, stali, aluminium czy drewna, do montażu paneli do uszczelnienia lub wypełnienia otworów.

Zastosowanie:

Klej do styropianu EPS i XPS idealnie sprawdzi się przy :

- mocowaniu płyt z białego i grafitowego polistyrenu ekspandowanego (EPS) i polistyrenu ekstrudowanego (XPS) do podłoża mineralnych przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową
- klejeniu paneli wewnętrznych
- uszczelnianiu dachówek
- montażu parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanych z kamienia, konglomeratu, mączek kamiennych, drewna, stali i aluminium

Sposób użycia:

1. Zalecana temperatura puszek z pianą +20°C, minimalna +5°C.
2. Oczyszczyć powierzchnię od kurzu, kawałków tynku itp.
3. Nakręcić pistolet na gwint butli i wstrząsaj przez około 30 sekund.
4. Nałożyć klej na płytę izolacyjną w jednej linii wzdłuż obwodu płyty (3-4 cm od krawędzi) i przez środek (równolegle do dłuższej krawędzi)
5. Po nałożeniu kleju na płytę, zaczekaj 2-3 minuty i przyciśnij ją do ściany.
6. Dołączone do ścian płyty z polistyrenu można korygować w ciągu 5 minut.
7. Wypełnić klejem otwory i szczeliny pomiędzy płytami (klej się rozpręży i wypełni puste przestrzenie). Świeże zabrudzenia usuniesz za pomocą Czyścika do pian SAXBO.

UWAGA! Utwardzony klej powinien być chroniony przed działaniem promieniowania UV. Gwarantowana zdolność do użycia- patrz nadruk na opakowaniu. przechowywać w pozycji pionowej, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed nasłonecznieniem. Ogrzanie do temperatury powyżej plus 50°C grozi rozerwaniem puszek.



Karta techniczna

Dane techniczne:

TEMPERATURA ROBOCZA PUSZKI	-5°C DO +30°C
TEMPERATURA OTOCZENIA PRACY	+15°C DO +25°C
CZAS TWORZENIA NASKÓRKA	OK 7 MINUT
CZAS OTWARTY	2-5 MINUT
CZAS KOREKTY	OK 5 MINUT
GĘSTOŚĆ	ok 36 kg/m ³
WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA	0,034W/M ² K
CZAS KOŁKOWANIA	JUŻ PO 2 GODZINACH
ODPORNOŚĆ TERMICZNA PO UTWARDZENIU	-60°C DO +110°C
KOLOR KLEJU	RÓŻOWY
CAŁKOWITE UTWARDZENIE	PO 24 GODZINACH

Sposób nałożenia na płytę:



Karta techniczna

Dane techniczne:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WYROBU BUDOWLANEGO DLA ZAMIERZONEGO ZASTOSOWANIA LUB ZASTOSOWAŃ	DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
PRZYROST WYSOKOŚCI PIANY (STOPIEŃ EKSPANSJI), mm	≤5,0
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCINANIE, kPa	≥70
MODUŁ SPRĘŻYSTOŚCI POPRZECZNEJ PRZY ŚCIANIU, kPa	≥200
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE PROSTOPADŁE DO POWIERZCHNI MPa, POŁĄCZENIA: PŁYTA Z BIAŁEGO LUB GRAFITOWEGO EPS - SPOINA KLEJOWA (8mm) - BETON, WYKONANEGO: • W WARUNKACH LABORATORYJNYCH • W WARUNKACH LABORATORYJNYCHPO CZASIE OTWARTYM 5 MIN. • W TEMP. +5°C • W TEMP. +30°C I 30%RH • NA NA PODŁOŻU Z BETONU WYGRZANYM DO 50°C	≥0,08
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE PROSTOPADŁE DO POWIERZCHNI MPa, POŁĄCZENIA: PŁYTA Z XPS - SPOINA KLEJOWA (8mm) - BETON, WYKONANEGO: • W WARUNKACH LABORATORYJNYCH • W WARUNKACH LABORATORYJNYCHPO CZASIE OTWARTYM 5 MIN. • W TEMP. +5°C • W TEMP. +30°C I 30%RH • NA NA PODŁOŻU Z BETONU WYGRZANYM DO 50°C	≥0,08
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE PROSTOPADŁE DO POWIERZCHNI MPa, POŁĄCZENIA: PŁYTA Z BIAŁEGO LUB GRAFITOWEGO EPS - SPOINA KLEJOWA (8mm) - PAPA, WYKONANEGO: • W TEMP. +30°C I 30%RH, NA PODŁOŻU Z PAPY WYGRZANEJ DO 50°C	≥0,08
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE PROSTOPADŁE DO POWIERZCHNI MPa, POŁĄCZENIA: PŁYTA Z XPS - SPOINA KLEJOWA (8mm) - PAPA, WYKONANEGO: • W TEMP. +30°C I 30%RH, NA PODŁOŻU Z PAPY WYGRZANEJ DO 50°C	≥0,08

Karta techniczna

Dane techniczne:

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE PROSTOPADŁE DO POWIERZCHNI, MPA, POŁĄCZENIA XPS-SPOINA KLEJOWA (8 MM) - PAPA WYKONANEGO W TEMPERATURZE +30°C I 30% RH, NA PODŁOŻU Z PAPY WYGRZANEJ DO 50°C

≥0,08

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE PROSTOPADŁE DO POWIERZCHNI MPA, POŁĄCZENIA XPS - SPOINA KLEJOWA (8mm) - BLACHA STALOWA OCYNKOWANA, WYKONANEGO W temp. +30°C I 30%RH, NA PODŁOŻU Z BLACHY STALOWEJ WYGRZANEJ DO 50°C

≥0,08

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE PROSTOPADŁE DO POWIERZCHNI MPa, POŁĄCZENIA PIR AL - SPOINA KLEJOWA (8mm) - PAPA, WYKONANEGO W TEMP. +30°C I 30%RH, NA PODŁOŻU Z PAPY WYGRZANEJ DO 50°C

≥0,08

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE PROSTOPADŁE DO POWIERZCHNI MPa, POŁĄCZENIA PIR ATX - SPOINA KLEJOWA (8mm) - PAPA, WYKONANEGO W TEMP. +30°C I 30%RH, NA PODŁOŻU Z PAPY WYGRZANEJ DO 50°C

≥0,08

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE PROSTOPADŁE DO POWIERZCHNI, MPA, POŁĄCZENIA EPS BIAŁY LUB GRAFITOWY-SPOINA KLEJOWA (8 MM) - BLACHA STALOWA OCYNKOWANA, WYKONANEGO W TEMP. +30°C I 30%RH, NA PODŁOŻU Z BLACHY STALOWEJ WYGRZANEJ DO 50°C

≥0,08

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE PROSTOPADŁE DO POWIERZCHNI MPa, POŁĄCZENIA PIR ALL - SPOINA KLEJOWA (8mm) - BLACHA STALOWA OCYNKOWANA, WYKONANEGO W temp. +30°C I 30%RH, NA PODŁOŻU Z BLACHY STALOWEJ WYGRZANEJ DO 50°C

≥0,08

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE PROSTOPADŁE DO POWIERZCHNI MPa, POŁĄCZENIA PIR ATX - BLACHA STALOWA OCYNKOWANA, WYKONANEGO W temp. +30°C I 30%RH, NA PODŁOŻU Z BLACHY STALOWEJ WYGRZANEJ DO 50°C

≥0,08

Opakowanie:

Produkt posiada pojemność 750ml netto, a jego waga to ok. 905g brutto.
Opakowanie zbiorcze to 12 sztuk. Na palecie mieści się 780 sztuk.

Przechowywanie:

Produkt należy przechowywać w pozycji pionowej, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed nasłonecznieniem. Ogrzanie do temperatury +50°C grozi rozerwaniem. Data ważności wybita jest na opakowaniu.

Karta techniczna

Uwagi końcowe:

Informacje w tym dokumencie opierają się na naszej wiedzy i badaniach. Producent odpowiada za jakość wyrobu oraz gwarantuje jego wysoki poziom. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza kontrolą producenta, nie może on przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. Stosując produkt należy przestrzegać zapisów niniejszej karty technicznej, przepisów BHP, zasad sztuki budowlanej oraz prawa krajowego. Przed zastosowaniem produktu należy wykonać próbę.